

主要市場收盤行情

市場	收盤	漲跌幅	市場	收盤	漲跌幅
道瓊	51621.48	-0.09%	美2Y債券	4.80	0.18%
標普500	7718.94	-1.11%	美10Y債券	5.19	-0.44%
那斯達克	26692.87	-1.88%	10Y美元SOFR	4.80	-0.35%
費半	11684.38	-4.30%	美元指數	102.55	0.37%
日經225	67744.29	-0.05%	布蘭特原油	106.06	0.35%
台灣加權	48625.83	0.59%	現貨黃金	4105.37	-1.33%

通膨升溫加深升息疑慮，美股收低科技承壓

盤勢分析

1) 通膨升溫美股收低

美國最新通膨數據高於預期，核心物價也顯示壓力，市場提高對聯準會再升息的預期。美股主要指數收低，那指與費半跌幅較大，道瓊相對抗跌，後續須觀察物價走勢及企業獲利能否支撐評價。

2) AI融資壓力擴散

CoreWeave股債同步承壓，市場擔憂AI基建的龐大借貸需求，賣壓擴及甲骨文與戴爾等企業。投資人重新檢視外部融資成本及現金流，後續須觀察訂單能否轉化為收入，以及資本支出的負擔。

3) 先進材料擴產布局

富士軟片將在美國亞利桑那州擴增研磨液設備，以因應先進製程與封裝需求，預計明年投產。產品預料供應鄰近台積電與英特爾，反映當地半導體材料需求持續擴大，後續仍須追蹤量產進度。

4) 升息疑慮壓抑黃金

美國通膨升溫推高升息預期，美元走強，現貨黃金回落，顯示通膨風險未必立即帶動金價上漲。央行購金與財政風險可提供長期支撐，但短線仍受政策預期牽動，配置宜分批並控制集中度。

市場觀察

通膨與AI融資疑慮壓抑美股，短線震盪加大。建議股債多元配置，分批布局優質資產，掌握中長期收益契機。

免責聲明暨注意事項 1、鑒於各資料係依據公開資訊及本行認為可靠之資料來源整理僅供參考之用。本行已盡力確保資訊之正確性與即時性，惟不保證其完整性及正確性，如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。2、本資料所載市場資訊與分析僅為一般性說明，不構成任何投資建議要約或招攬。投資人於進行投資決策前應審慎評估自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，並自行承擔投資風險與投資結果。3、本資料如涉及外國有價證券或金融商品，其相關資訊係依各該國法令辦理，投資人應留意包括市場價格波動、匯率變動及其他相關風險。4、本資料所提及之經濟或市場趨勢預測，僅為分析判斷，不代表相關金融商品之未來績效。投資前請詳閱產說明文件並留意最新市場資訊。 5、未經本行同意，不得將本資料全部或部分內容進行抄錄、轉載或散布。